

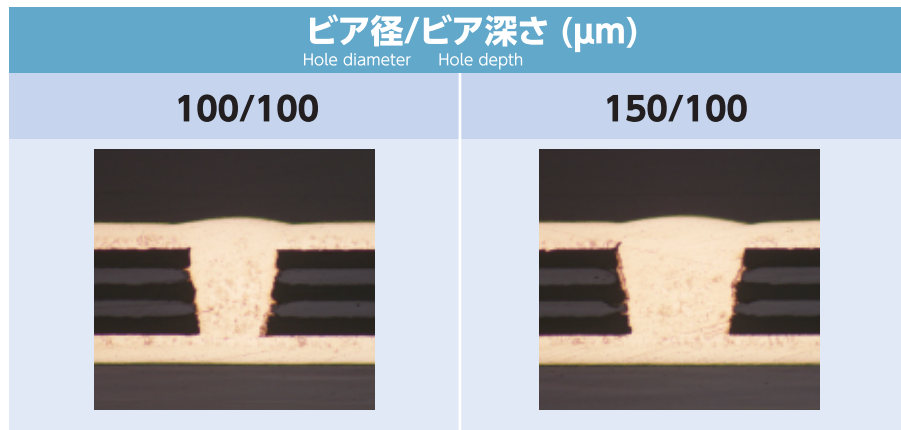
トッパールチナGAP

TOP LUCINA GAP

- フィリング性に優れ、大口径ビアにも対応
Excellent via-filling performance for large-diameter via-holes
- スルーホールフィリングにも対応
Applicable to through-hole filling
- パターンの幅や疎密にかかわらず、めっき膜厚の均一性に優れる
Regardless of pattern size/density, uniform thickness is available

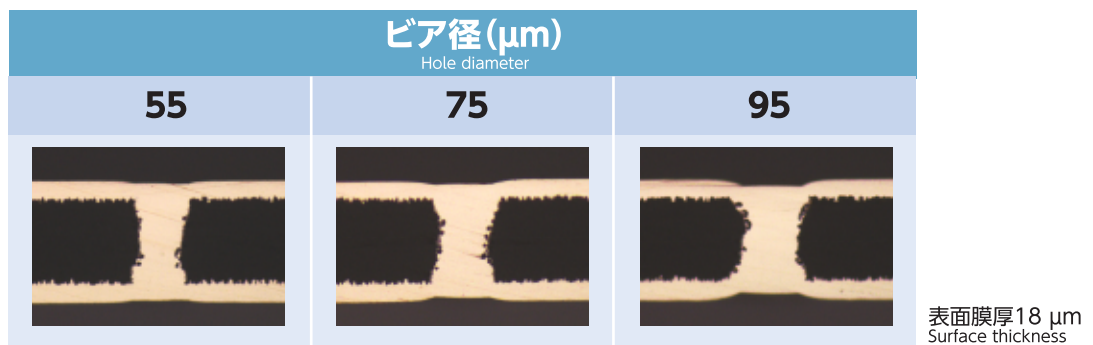
大口径ビアで優れたフィリング性を発揮

Excellent via-filling performance for large-diameter via-holes



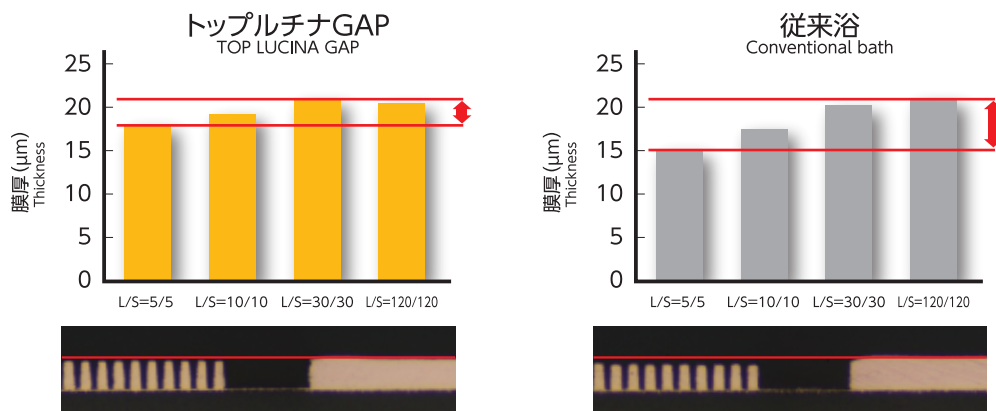
高いスルーホールフィリング性を実現

Realize high through-hole filling performance



配線幅間の膜厚のばらつきが小さい

Small thickness variation between patterns



細線の膜厚均一性が良好

Excellent in thickness uniformity for micro patterns